

生瓷激光冲孔和切割设备 LM系列



- 处理速度快
- 适用于在生瓷片上钻孔或切割成所需的任何形状
- 两种不同的激光源可用**IR**或**UV**激光
- 高精度光学光束定位系统确保高精度冲孔及切割
- 证明与机械冲孔效果类似的冲孔机

灵活高效的生瓷片加工设备

激光陶瓷加工设备适用于钻孔或切割矩形或任何其他形状的腔体，主要用于生陶瓷带。加工速度快，无工具磨损情况，使用激光加工与机械冲孔相比具有很强的竞争力。有两种激光源类型可供选择。用于一般生陶瓷片加工的光纤激光源和用于大多数要求苛刻的应用的高功率UV激光源。安装了最先进的激光源，光束定位系统和光学器件，以便激活定义的和更长的热源可得到重复加工效果。设备机械设计和膜带上料方式，类似于我们的机械冲孔机，使它们非常具有竞争力。

成功的激光加工过程对材料是敏感的。用所述激光源钻孔或切割透明载体膜是不太可能的。如果需要，必须使用适合激光加工的载体膜。

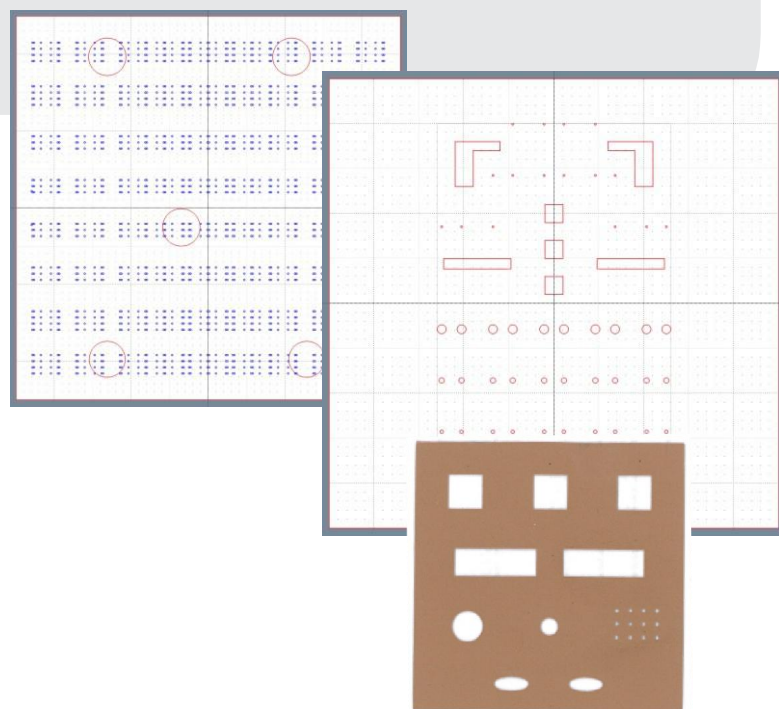
生陶瓷带包含不同的陶瓷和不同的有机物，因此我们建议对特定材料进行激光钻孔或切割测试。

技术规格:

- 激光束定位原理: 扫描头
- 扫描头行程范围: 90x90 mm最大, 推荐 50x50 mm, 可接受客户定制
- 总的工作区域a: 达250x250 mm通过移动膜片
- 最大膜片厚度: 254 μ m
- 最小冲孔孔径:
 - IR 激光: 60 μ m
 - UV 激光: 30 μ m
- 冲孔速度: 20 to 800 孔/S
冲孔速度取决于很多参数: 孔径, 膜片厚度, 工作参数, 激光源
- 控制: PLC+PC
- 大概尺寸: L x W x H: 1,8 m (70 inch) x 1,3 m (51 inch) x 2,0 m (79 inch) (取决于设备版本)
- 电源: 可根据客户要求
- 功率: 约4 to 6 kW
- 压缩空气: 0,6 MPa, 100 L/min.
- 真空: -0.09 MPa (0.01 MPa 独立), 200 L/min.
- 排风: 排风口连接需求, 400m³/h min.

选配:

- 膜片清洁装置
- 条码喷读装置



如何选型:*

LM - XXX

膜片上料:
M-手动上下料
CC-自动从料盒上下料
RC - 卷状上料, 料盒下料

激光类型: **U** - UV 激光
I - IR 激光

膜片尺寸: **4, 6, 8, 10** inch

激光机

* 选配及其它需求需单独提出
 建议在确认之前先进行材料测试